

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 0981)

中芯截至二零零四年六月三十日止三个月业绩公布

- 本公司谨于今日公布截至二零零四年六月三十日止三个月的未经审核经营业绩。
 - 销售额由上季的 186,900,000 元增至二零零四年第二季的 221,000,000 元, 增幅 18.2%。
 - 经营溢利由上季的 26,800,000 元增至二零零四年第二季的 36,400,000 元, 增幅 35.6%。
 - 普通股持有人应占收入增至 34,200,000 元, 较二零零四年首季 8,600,000 元上升 296.7%。
- 以下为本公司于二零零四年七月三十日就截至二零零四年六月三十日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。
- 由于本公司于二零零四年七月三十日在美国作出报章公布(现转载如下), 因此根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条及上市协议第 2(1)段规定的披露责任而作出本公布。

以下为本公司于二零零四年七月三十日就截至二零零四年六月三十日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

所有货币数字均以美元列账, 除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

中芯二零零四年第二季业绩报告

概要

- 销售额增至 221,000,000 元, 较二零零四年首季 186,900,000 元上升 18.2%。
- 经营溢利增至 36,400,000 元, 较二零零四年首季 26,800,000 元上升 35.6%。

- 普通股持有人应占收入增至 34,200,000 元, 较二零零四年首季 8,600,000 元上升 296.7%。
- 较 2004 年首季晶圆付运增加 15.6%至 201,534 片 8 吋等值晶圆; 综合平均售价上升 2.6%至 1,034 元。
- 每股基本盈利——每股普通股 0.0019 元 (港币 0.0149 元⁽¹⁾), 每股美国预托股 0.0955 元。
- 每股摊薄盈利——每股普通股 0.0019 元 (港币 0.0147 元⁽¹⁾), 每股美国预托股 0.0941 元。

中国上海—二零零四年七月三十日—国际主要半导体承包制造商中芯国际集成电路制造有限公司 (纽约交易所: SMI; 香港联交所: 981) (「中芯」或「本公司」) 于今日公布截至二零零四年六月三十日止三个月的综合经营业绩。二零零四年第二季销售额由上一季度的 186,900,000 元增加 18.2%至 221,000,000 元。二零零四年第二季经营溢利由上一季度的 26,800,000 元增加 35.6%至 36,400,000 元。

本公司报告普通股持有人应占收入增至 34,200,000 元, 较二零零四年首季 8,600,000 元上升 296.7%相当于每股普通股 0.0019 元 (港币 0.0149 元⁽¹⁾) 及每股美国预托股 0.0955 元按全面摊薄基准计算则为每股普通股 0.0019 元 (港币 0.0147 元⁽¹⁾) 及每股美国预托股 0.0941 元。

附注: (1) 根据二零零四年七月二十八日的终结汇率, 7.80 港币=1 美元 (来源: Bloomberg)。

“我们很高兴地报告二零零四年第二季度公司业绩持续增长”中芯国际总裁兼总执行长张汝京先生表示“在二零零四年第二季度我们扩大了工艺范围并获得了十五家新客户, 其中七家为中国非厂房半导体公司。我们从客户那里获得了从整个市场份额来看相对较强的订单支持, 尤其是消费类产品市场的客户。我们继续实施我们的商业计划, 天津七厂开始投产, 北京四厂也已经在七月二十三日试生产并将按计划二零零四年晚些时候开始生产。另外, 我们与凸版印刷公司建立一家制造及销售芯载滤色镜(on-chip color filters)和微镜(micro lenses)的战略合资公司以及将在成都建立一家封装测试厂。我们相信这些成绩为公司接下来半年和未来持续稳健的成长奠定了良好的基础。”

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期: 二零零四年七月三十日

时间: 上海时间上午八时三十分正

拨号及登入密码: 美国 1-617-801-9711 (密码: 70633890) 或香港 852-3002-1672 (密码: 70633890)。

二零零四年第二季业绩公布网上直播可于 www.smics.com 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

有关中芯

中芯（纽约交易所：SMI；香港联交所：0981.HK）是全球首屈一指的半导体承包制造厂之一。作为一家半导体承包制造厂，中芯提供以 0.35 微米至 0.13 微米技术制造的集成电路。中芯成立于二零零零年四月，是一家开曼群岛公司，于中国上海张江高科技园区营运三间 8 吋晶圆装配厂，以及于天津营运一间 8 吋晶圆装配厂。此外，中芯现正在中国北京兴建一间 12 吋晶圆装配厂房。二零零三年五月，中芯一厂获同业主要刊物《半导体国际》杂志选为「二零零三年度最佳的两个半导体厂之一」。除制造集成电路以外，中芯亦为客户提供一应俱全的服务，包括设计服务、光罩制造及晶圆探测测试等。其它资料详情，请浏览 www.smics.com。

安全港声明

（根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据 1995 私人有价证券诉讼改革法案所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，为并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知风险、不确定性，以及其它可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体承包制造服务供求情况、市场产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（「证交会」）的文件资料，包括其于二零零四年三月十一日以 F-1 表格（经修订）形式呈交予证交会的登记声明，特别是「风险因素」及「有关财政状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份、其于二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港联合交易所（「香港联交所」）的登记声明，以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件，包括 6-K 表格。其它未知或不可逆料的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素，本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请 阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则本新闻发布日期）的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Jimmy Lai

Sarina Huang

投资者关系部负责人
电话：86-21-5080-2000，内线 16088
传真：86-21-5080-3070

公共关系部
电话：86-21-5080-2000，内线 10356
传真：86-21-5080-2868

Evonne Hwang
投资者关系部
电话：86-21-5080-2000，内线 16275
传真：86-21-5080-3070

Calvin Lau
投资者关系部
电话：86-21-5080-2000，内线 16693
传真：86-21-5080-3070

概要：

以千美元为单位（每股盈利除外）

	<u>二零零四年第二季</u>	<u>二零零四年首季</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年第二季</u>	<u>年度比较</u>
销售	220,988	186,937	18.2%	75,193	193.9%
销售成本	(159,507)	(126,781)	25.8%	(88,645)	79.9%
毛利	61,481	60,156	2.2%	(13,452)	-
经营开支	(25,091)	(33,313)	-24.7%	(14,451)	73.6%
经营溢利	36,390	26,843	35.6%	(27,903)	-
其它收入	(2,225)	609	-	(2,611)	-14.8%
收入净额	34,165	27,452	24.5%	(30,514)	-
未发盈余	0	(18,839)	-100.0%	0	-
普通股持有人应占收入	34,165	8,613	296.7%	(30,514)	-
毛利率	27.8%	32.2%		-17.9%	
经营利润率	16.5%	14.4%		-37.1%	
每股基本盈利—每股普通股 1)	\$0.0019	\$0.0033		\$0.3428	
每股基本盈利—每股美国预托股份	\$0.0955	\$0.1630		\$17.1405	
每股摊薄盈利—每股普通股	\$0.0019	\$0.0005		\$0.3428	
每股摊薄盈利—每股美国预托股份	\$0.0941	\$0.0273		\$17.1405	
付运晶圆（千片 8 吋等值）(2)	201,534	174,325	15.6%	117,950	70.9%
综合平均售价	\$1,034	\$1,008	2.6%	\$614	68.4%
逻辑平均售价(3)	\$1,089	\$1,081	0.7%	\$797	36.6%
产能使用率	99%	99%		97%	

附注：

(1) 基于二零零四年第二季加权平均普通股 17,897,000,000 股和二零零四年首季 2,641,000,000 股。

(2) 包括铜接连线

(3) 不包括铜接连线

- 销售额增至 221,000,000 元，较二零零四年首季的 186,900,000 元录得季度升幅 18.2%，并较二零零三年第二季的 75,200,000 元录得年度升幅 193.9%。导致此等上升的主要因素如下：
 - 二零零四年第二季末产能增加至 80,872 片 8 吋晶圆；
 - 晶圆付运增至 201,534 片，较二零零四年首季的 174,325 片录得季度升幅 15.6%；
 - 99%的高使用率；及
 - 透过在产品组合中陆续加入更多定价较高的晶圆产品，平均售价上升至 1,034 元，较二零零四年首季的 1,008 元上升 2.6%。
- 销售成本从上季的 126,800,000 元增加到 159,500,000 元，主要由于晶圆付运增加，天津七厂的投产阶段折旧费用以及计划中的设备年度维修。
- 毛利增至 61,500,000 元，较二零零四年首季的 60,200,000 元录得季度升幅 2.2%，二零零三年第二季则为亏损 13,500,000 元。
- 研发费用下降至 13,500,000 元，较上季的 16,500,000 元下降 18.2%，主要由于天津七厂的开办费用在二零零四年首季归类于研发费用，天津七厂的开办期已于二零零四年三月三十一日结束。
- 一般行政费用从首季 10,500,000 元减少 9.4%至 9,500,000 元。纯粹一般行政费用则是 6,000,000 元，差额主要因外汇变动收益 3,500,000 元。
- 一般和管理费用下的汇兑收益 3,500,000 元是指与经营活动（如应收账款或应付账款）相关的汇兑收益。汇兑损失 2,400,000 元是指与融资或投资活动（如远期合约归类为其它业务收入/支出）相关的非经营性活动产生的汇兑损失。净外汇变动收益是 1,100,000 元。
- 销售及市场推广费用从二零零四年首季 1,700,000 元增加 11.1%至二零零四年第二季度 1,900,000 元。
- 经营溢利增至 36,400,000 元，较二零零四年首季的 26,800,000 元录得季度升幅 35.6%，二零零三年第二季则为亏损 27,900,000 元。
- 二零零四年第二季利息收入增加至 2,700,000 元，主要由于公开发售所得款项中增加的现金孳生的利息收入所致。
- 二零零四年第二季度其它非营业性亏损 2,200,000 元主要是因外汇变动损失的 2,400,000 元。

- 净收入增至 34,200,000 元，较二零零四年首季的 27,500,000 元录得季度升幅 24.5%，二零零三年第二季则为亏损 30,500,000 元。
- 普通股持有人应占收入增至 34,200,000 元，较二零零四年首季的 8,600,000 元录得季度升幅 296.7%，主要是由于二零零四年首季扣除了一次性非现金优先股未发盈余 18,800,000。

1. 收入分析

销售分析					
	二零零四年	二零零四年	二零零三年	二零零三年	二零零三年
以应用分类	第二季	首季	第四季	第三季	第二季
计算机	22.5%	25.1%	26.7%	33.3%	49.8%
通讯	54.3%	56.0%	55.8%	48.2%	32.5%
消费	17.1%	12.7%	13.5%	11.7%	11.3%
其它	6.1%	6.2%	4.0%	6.8%	6.4%
	二零零四年	二零零四年	二零零三年	二零零三年	二零零三年
以装置分类	第二季	首季	第四季	第三季	第二季
逻辑（仅包括铜连接件）	73.5%	72.4%	71.6%	60.0%	43.3%
内存	20.8%	21.6%	24.5%	34.0%	53.0%
其它（光罩制造及探测）	5.7%	6.0%	3.9%	6.0%	3.7%
	二零零四年	二零零四年	二零零三年	二零零三年	二零零三年
以客户类别分类	第二季	首季	第四季	第三季	第二季
非厂房半导体公司	36.1%	36.6%	30.8%	31.1%	38.2%
集成装置制造商	54.8%	54.0%	62.7%	49.2%	29.9%
系统公司及其它	9.1%	9.4%	6.5%	19.7%	31.9%
	二零零四年	二零零四年	二零零三年	二零零三年	二零零三年
以地区分类	第二季	首季	第四季	第三季	第二季
北美洲	44.0%	41.4%	36.2%	38.8%	39.6%
亚太区（不包括日本）	26.5%	27.2%	28.6%	38.2%	54.6%
日本	16.2%	16.3%	15.5%	13.3%	4.2%
欧洲	13.3%	15.1%	19.7%	9.7%	1.6%
晶圆收入分析					
以技术分类	二零零四年	二零零四年	二零零三年	二零零三年	二零零三年
（仅包括逻辑、记忆及铜连接件）	第二季	首季	第四季	第三季	第二季
0.13 酸	9.9%	10.1%	10.4%	15.0%	13.5%
0.15 酸	13.3%	15.7%	17.5%	10.0%	0.0%
0.18 酸	48.6%	44.4%	34.7%	19.7%	10.5%
0.25 酸	8.3%	8.3%	10.6%	33.7%	57.4%

0.35 酸	19.9%	21.5%	26.8%	21.6%	18.6%
	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零三年</u>	<u>二零零三年</u>	<u>二零零三年</u>
以逻辑分类(1)	<u>第二季</u>	<u>首季</u>	<u>第四季</u>	<u>第三季</u>	<u>第二季</u>
0.13 酸	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.15 酸	3.9%	4.4%	1.9%	0.3%	0.1%
0.18 酸	63.0%	58.5%	52.9%	40.3%	33.3%
0.25 酸	3.1%	5.0%	3.4%	15.1%	7.6%
0.35 酸	29.1%	32.1%	41.8%	44.3%	59.0%

附注：

(1) 不包括 0.13 酸铜接连件

- 相较二零零四年首季而言，二零零四年第二季消费类别的销售额较其它应用技术增长更快。
- 二零零四年第二季逻辑晶圆(包括铜接连件) 的销售百分比上升至占销售额达 73.5%，二零零四年首季及二零零三年第二季度则分别为 72.4%及 43.3%。
- 集成装置制造商占二零零四年第二季销售额 54.8%，非厂房公司则占 36.1%。
- 二零零四年第二季源自北美洲客户的销售百分比上升至 44%，二零零四年第一季度则为 41.4%。
- 二零零四年第二季 0.18 酸及以下技术的销售百分比上升至占销售额达 71.8%，二零零四年首季及二零零三年第二季度则分别为 70.2%及 24%。
- 二零零四年第二季 0.18 酸逻辑晶圆的销售百分比上升至 63%，二零零四年首季则为 58.5%。

产能:

期终每月晶圆计, 8 吋等值

厂 / (晶圆尺寸)	二零零四年第二季	二零零四年首季
一厂 (8 吋)	33,675	31,720
二厂 (8 吋)	31,098	24,400
七厂 (8 吋)	6,000	0
每月晶圆装配总产能	70,773	56,120
铜接连件:		
三厂 (8 吋)	10,099	9,300
每月铜接连件总产能	10,099	9,300

* 截至二零零四年第二季度终结时, 由于本公司不断提升一、二、三厂及七厂的冲次表现, 每月产能增加至 80,872 件晶圆。

付运及使用率:

8 吋晶圆	二零零四年 第二季	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	二零零三年 第三季	二零零三年 第二季
付运晶圆 (包括铜接连件)	201,534	174,325	153,125	130,780	117,950
使用率 ⁽¹⁾	99%	99%	97%	93%	97%

附注:

(1) 使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

• 二零零四年第二季晶圆付运量为 201,534 件 8 吋晶圆, 分别较二零零四年首季及二零零三年第二季度上升 15.6%及 70.9%。

• 使用率始终保持在 99%。

综合平均售价趋势

逻辑平均售价趋势

(不包括 0.13 酸铜接连件)

二零零四年第二季综合平均售价分别由二零零四年首季及二零零三年第二季度的 1,008 元及 614 元上升至 1,034 元。主要原因在于本公司转而生产更多逻辑产品，减产 DRAM 晶圆、采纳更先进及更高利润的处理技术。

二零零四年第二季逻辑平均售价（不包括 0.13 酸铜接连件）分别由二零零四年首季及二零零三年第二季度的 1,081 元及 797 元上升至 1,089 元。主要原因在于本公司转而生产更先进（ ≤ 0.18 酸）的逻辑晶圆，采纳更先进及更高利润的处理技术。

2. 详细财务分析

毛利分析

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 首季	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> 第二季	<u>年度比较</u>
销售成本	(159,507)	(126,781)	25.8%	(88,645)	79.9%
折旧和摊销	(83,990)	(64,423)	30.4%	(44,807)	87.4%
其它制造成本	(75,517)	(62,358)	21.1%	(43,838)	72.3%
毛利	61,481	60,156	2.2%	(13,452)	-
毛利率	27.8%	32.2%		-17.9%	

- 销售成本从上季的 126,800,000 元增加到 159,500,000 元，主要是由于晶圆付运增加，天津七厂的投产阶段折旧费用以及计划中的设备年度维修。

- 毛利增至 61,500,000 元，较二零零四年首季的 60,200,000 元录得季度升幅 2.2%，二零零三年第二季则为亏损 13,500,000 元。

经营开支分析

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> 第二季	<u>二零零四年</u> 首季	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> 第二季	<u>年度比</u> <u>较</u>
总经营开支	(25,091)	(33,313)	-24.7%	(14,451)	73.6%
一般及行政	(6,019)	(10,688)	-43.7%	(2,849)	111.3%
销售及市场推广	(1,940)	(1,747)	11.1%	(2,285)	-15.1%
研究及开发	(13,533)	(16,540)	-18.2%	(8,118)	66.7%
递延股份报酬摊销	(3,599)	(4,338)	-17.0%	(1,199)	200.1%

- 总经营开支下降至 25,100,000 元,较二零零四年首季的 33,300,000 元录得季度降幅 24.7% , 并较二零零三年第二季的 14,500,000 元录得年度升幅 73.6%。
- 一般行政费用从首季的 10,500,000 元减少 9.4%至 9,500,000 元, 纯粹的行政费用则是 6,000,000 元, 差额主要是由于外汇变动所导致的收益 3,500,000 元。
- 研究及开发费用降至 13,500,000 元, 较上季的 16,500,000 元录得季度降幅 18.2% , 主要由于天津七厂的开办费用在二零零四年首季归类于研发费用, 天津七厂的开办期已于二零零四年三月三十一日结束。

非经营项目

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季</u>	<u>二零零四年</u> <u>首季</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零三年</u> <u>第二季</u>	<u>年度比较</u>
其它收入, 净额	(2,225)	609	-	(2,611)	-14.8%
利息收入	2,733	1,484	84.2%	392	597.6%
利息支出, 扣除政府补贴	(2,760)	(2,743)	0.6%	(146)	1789.0%
其它, 净额	(2,198)	1,868	-	(2,857)	-23.1%

- 二零零四年第二季利息收入增至 2,700,000 元, 主要是从本公司首次公开发售所得款项中增加的现金金额孳生的利息收入。
- 二零零四年第二季其它非营业性损失 2,200,000 元主要是由于外汇变动中亏损的 2,400,000 元所致。

3. 流动资金

<u>以千美元计</u>	<u>二零零四年第二季</u>	<u>二零零四年第一季</u>
现金及现金等价物	1,198,592	1,373,072
短期投资	90,464	27,306
应收账款	131,708	116,812
存货	113,563	85,479
其它	40,459	50,383
总流动资产	1,574,786	1,653,052
应付账款	699,587	390,071
长期借款的即期部份	95,992	95,992
其它	54,443	88,951

总流动负债	850,022	575,014
现金比率	1.4x	2.4x
速动比率	1.7x	2.7x
流动比率	1.9x	2.9x

- 现金及现金等价物由 1,373,000,000 元降至 1,199,000,000 元，主要由于一、二、三、四厂和七厂发展的资本开支所致。

应收账款 / 存货的各日走势

资本结构

<i>以千美元计</i>	<u>二零零四年第二季</u>	<u>二零零四年首季</u>
现金及现金等价物	1,198,592	1,373,072
短期投资	90,464	27,306
长期借款的即期部份	95,992	95,992
长期借款	413,965	397,898
总借款	509,957	493,890
现金净额	779,099	906,488
股东权益	3,065,507	2,894,431
总借款对权益比率	16.6%	17.1%

- 总借款由二零零四年首季的 493,900,000 元增至二零零四年第二季的 510,000,000 元。
- 总借款对权益比率由二零零四年首季的 17.1% 下降至二零零四年第二季的 16.6%。

4. 现金流量及资本开支

<i>以千美元计</i>	<u>二零零四年第二季</u>	<u>二零零四年首季</u>
收入净额	34,165	27,452
折旧及摊销	101,790	84,264
所购无形资产摊销	3,532	3,237

现金变动净额	(174,480)	927,796
--------	-----------	---------

资本开支计划

- 计划下的二零零四年资本开支仍为 1,950,000,000 元。

5. 二零零四年第三季展望及指引

- 晶圆付运预期增加 23%-27%。
- 使用率预计仍处于接近 100%。
- 按季度比较下综合 ASP 预计持平或轻微上升。
- 0.18 酸及以下的销售百分比，不包括铜连接件，预计应增加几个百分点。
- 逻辑晶圆包括铜连接件的销售百分比预计将略有上升。
- 毛利率预计比二零零四年第二季略有好转。
- 经营开支相对销售的百分比预计将上升至高百分之十几，主要是由于与北京开办期间相关的研发费用的增加和 90 纳米技术的研发费用。
- 非营利性利息费用预计将增加约 2,000,000 元，主要是由于公司将更多使用先有的授信工具下的借款。
- 资本开支约为 700,000,000 元。
- 折旧及摊销约为 125,000,000 元至 130,000,000 元。
- 递延补偿开支约为 7,000,000 元，其中约 3,000,000 元将于经营开支中扣账及销售成本为 4,000,000 元。

6. 近期公布

- 凸版印刷公司与中芯国际签署建立合资公司协议（二零零四年七月二十一日）

- 明导公司向中芯国际提供用于 0.18 微米混合信号制程的技术设计工具(TDK)和设计流程。(二零零四年七月八日)
- 凸版印刷公司与中芯国际达成初步协议合资在中国建立一家制造及销售专供影像传感器使用的芯载滤色镜的公司。(二零零四年六月二十八日)
- 中芯国际开发出面积更小功能更大的 0.35 微米可擦写内存的非接触性智能卡技术(二零零四年六月八日)
- 中芯国际集成电路制造有限公司将在加州法院对台湾集成电路制造股份有限公司有关商业机密的指控提出强力辩护(二零零四年六月四日)
- 中芯国际北京的首个 12 英寸晶圆厂开始设备进厂(二零零四年六月二日)

上述公布详情请参阅中芯网站 www.smics.com。

中芯财务资料

合并资产负债表
(美元)

截至以下日期止三个月

资产负债表

	二零零四年六月三十日 (未经审核)	二零零四年三月三十一日 (未经审核)
资产		
流动资产:		
现金及现金等价物	1,198,592,423	1,373,072,249
短期投资	90,463,911	27,306,329
应收账款, 已扣除拨备(二零零四年六月三十日 为 356,826 元, 二零零四年三月三十一日为 76,435 元)	131,707,549	116,812,161
存货	113,562,540	85,479,153
预付款项及其它流动资产	7,867,504	17,792,517
待售资产	32,591,632	32,589,744
流动资产合计	1,574,785,559	1,653,052,153
土地使用权, 净额	34,803,658	34,975,122
物业、厂房及设备总额	3,159,564,426	2,515,158,260
累计折旧	(501,436,777)	(399,819,426)
物业、厂房及设备, 净额	2,658,127,649	2,115,338,834
购入无形资产, 净额	61,777,449	60,973,178
持至到期投资	-	3,004,297
资产合计	4,329,494,315	3,867,343,584
负债及股东权益		
流动负债:		
长期借款的即期部份	95,991,900	95,991,558
应付账款	699,586,755	390,071,430
已收股东按金	200,000	37,972,810
预提费用及其它流动负债	54,243,275	50,978,423

流动负债合计	850,021,930	575,014,221
长期负债：		
长期借款	413,965,135	397,898,517
长期负债合计	413,965,135	397,898,517
负债合计	1,263,987,065	972,912,738
承诺		
股东权益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零四年六月三十日已发行股份为 18,224,817,017 股，截止二零零四年三月三十一日已发行股份为 18,201,735,490 股	7,289,927	7,280,694
认股权证	124,920	124,920
额外缴入股本	3,294,693,501	3,291,984,495
应收股东认购款项	—	(93,000,000)
应收股东票据	(1,891,580)	(34,160,683)
累计其它综合盈余（亏损）	400,320	254,625
递延股票报酬	(70,597,602)	(79,375,571)
累计亏绌	(164,512,236)	(198,677,634)
所有股东权益合计	3,065,507,250	2,894,430,846
总负债及股东权益合计	4,329,494,315	3,867,343,584

合并营运报表
(美元)

截至以下日期止三个月

	二零零四年六月三十日 (未经审核)	二零零四年三月三十一日 (未经审核)
销售额	220,988,561	186,936,986
销售成本	(156,952,228)	(124,115,756)
销售成本—摊销递延股票报酬	(2,554,781)	(2,665,247)
毛利	61,481,552	60,155,983
经营费用:		
研究和开发	(13,532,637)	(16,539,866)
一般管理	(6,019,392)	(10,687,939)
销售和市场推广	(1,940,035)	(1,746,901)
摊销递延股票报酬*	(3,599,151)	(4,338,052)
经营费用总额	(25,091,215)	(33,312,758)
经营收入	36,390,337	26,843,225
其它收入(支出):		
利息收入	2,732,629	1,483,715
利息支出	(2,759,605)	(2,743,377)
其它净额	(2,197,963)	1,868,584
其它净收入	(2,224,939)	608,922
收入净额	34,165,398	27,452,147
视为就优先股派付的股息(1)	—	(18,839,426)
普通股持有人应占收入净额	34,165,398	8,612,721

每股股份收入净额，基本	0.0019	0.0033
每股美国预托股份收入净额，基本(1)	0.0955	0.1630
每股股份收入净额，摊薄	0.0019	0.0005
每股美国预托股份收入 净额，摊薄(1)	0.0941	0.0273
用作计算基本每股收入 净额的股份（以百万计）	17,897	2,641
用作计算摊薄每股收入 净额的股份（以百万计）	18,147	15,793

* 摊销递延股票报酬乃关于：

研究和开发	1,301,741	1,315,047
一般和管理	1,671,586	2,394,664
销售及市场推广	625,824	628,341
总计	<u>3,599,151</u>	<u>4,338,052</u>

(1) 一股美国预托股份等于 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

截至以下日期止三个月
二零零四年 二零零四年
六月三十日 三月三十一日
(未经审核) (未经审核)

经营活动

普通股持有人应占收入	34,165,398	8,612,721
视为已派付优先股股息	—	18,839,426
收入净额	<u>34,165,398</u>	<u>27,452,147</u>
收入净额至经营活动所得(所耗)现金净额对账的调整:		
出售厂房及设备的收益	20,676	(198,351)
呆账拨备	280,391	(38,038)
折旧及摊销	101,789,774	84,263,652
摊销购入无形资产	3,531,649	3,237,098
摊销递延股票报酬	6,153,932	7,003,300
营运资产及负债的变动:		
应收账款	(15,175,779)	(26,235,606)
存货	(28,083,387)	(15,555,274)
预付款及其它流动资产	10,148,004	(1,218,597)
应付账款	21,703,089	13,125,287
预扣费用及其它流动负债	7,876	15,963,862
经营活动所得现金净额	<u>134,541,623</u>	<u>107,799,480</u>

投资活动

购买物业、厂房及设备	(351,833,464)	(225,979,371)
购买购入无形资产	(2,611,626)	—
购买短期投资	(64,132,303)	(2,093,043)
出售短期投资	1,005,977	2,017,960
出售长期投资	3,004,297	427
待售资产已收款项	1,530,794	445,071

出售厂房及设备收到款项	440,078	38,057
投资活动所耗现金净额	(412,596,247)	(225,570,899)

融资活动

偿还购买土地使用权而应付股东款项	—	(13,658,773)
长期借款所得款项	16,066,960	13,929,500
偿还可赎回可转换承兑票据	—	(15,000,000)
发行普通股所得款项	—	1,017,051,336
发行 D 类可换股优先股所得款项	—	29,975,000
行使雇员购股权所得款项	32,166,207	1,840,682
收取应收认购款项	93,000,000	12,420,031
已收股东按金变动	(37,772,810)	(378,597)
C 类发行费用付款	—	(600,000)

融资活动所得现金净额	103,460,357	1,045,579,179
------------	-------------	---------------

率变动的的影响	114,441	(11,845)
---------	---------	----------

现金及现金等价物减少净额	(174,479,826)	927,795,915
--------------	---------------	-------------

现金及现金等价物—二零零四年四月一日（二零零四年一月一日）	1,373,072,249	445,276,334
-------------------------------	---------------	-------------

现金及现金等价物—二零零四年六月三十日（二零零四年三月三十一日）	1,198,592,423	1,373,072,249
----------------------------------	---------------	---------------

于本公布刊发日期，本公司董事分别有张汝京、蔡来兴、姚方（蔡来兴的替任董事）、徐大麟、Sean Hunkler、周延鹏、川西刚、萧崇河、陈立武及王阳元。

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
主席
张汝京
香港，二零零四年七月三十日

* 仅供识别